

Title (en)

Process for the preparation of an additive for an acid bath for the electrodeposition of copper and use thereof.

Title (de)

Verfahren zur Herstellung eines Zusatzmittels für ein saures Kupferelektroplattierbad und seine Verwendung.

Title (fr)

Procédé de préparation d'un additif pour bain de cuivrage électrolytique acide et son application.

Publication

EP 0071512 A1 19830209 (FR)

Application

EP 82401328 A 19820716

Priority

FR 8114394 A 19810724

Abstract (en)

[origin: US4430173A] Additive composition for an acid copper electroplating bath, which bath being well adapted for the copper plating of printed circuits, is comprised of (1) the sodium salt of omega -sulfo-n-propyl N,N-diethyldithiocarbamate, (2) polyethylene glycol having an average molecular weight ranging from about 6,000 to 20,000, (3) crystal violet, and (4) sulfuric acid.

Abstract (fr)

La présente invention concerne un additif pour bain de cuivrage électrolytique acide, son procédé de préparation et application au cuivrage des circuits imprimés. L'additif est caractérisé en ce qu'il comprend le N,N diéthylthiocarbamate de n propyle ω sulfonate de sodium, un polyéthylène glycol de poids moléculaire moyen compris entre 6000 et 20 000, le cristal violet, de l'acide sulfurique. L'additif selon l'invention est utilisable dans les opérations de métallisation.

IPC 1-7

C25D 3/38

IPC 8 full level

H05K 3/18 (2006.01); **C25D 3/38** (2006.01); **C25D 7/00** (2006.01)

CPC (source: EP US)

C25D 3/38 (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [Y] US 4036710 A 19770719 - KARDOS OTTO, et al
- [Y] US 4038161 A 19770726 - ECKLES WILLIAM EDWARD, et al
- [X] CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 82, no. 26, 30 juin 1975, page 415-416, no. 177072u, Columbus Ohio (USA);

Cited by

DE4032864A1; CN110284163A; DE4126502C1; US5433840A; DE19758121A1; DE19758121C2; DE10337669A1; DE10337669B4

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0071512 A1 19830209; EP 0071512 B1 19850605; AT E13697 T1 19850615; DE 3264038 D1 19850711; FR 2510145 A1 19830128; FR 2510145 B1 19860207; HK 96586 A 19861219; IE 53352 B1 19881026; IE 821754 L 19830124; JP S5827992 A 19830218; JP S6155599 B2 19861128; SG 64086 G 19870918; US 4430173 A 19840207

DOCDB simple family (application)

EP 82401328 A 19820716; AT 82401328 T 19820716; DE 3264038 T 19820716; FR 8114394 A 19810724; HK 96586 A 19861211; IE 175482 A 19820722; JP 12684882 A 19820722; SG 64086 A 19860724; US 39880582 A 19820716